Factsheet



Neue Halbleiter-Fertigung von Bosch in Dresden

24. April 2018 PI 10634 AE/MBC

Allgemeine Informationen

► Investitionssumme rund 1 Milliarde Euro

► Bauablauf Stützmauer November 2017

Gründungsarbeiten März 2018

Spatenstich April 2018

► Fertigstellung Maschineninstallation Ende 2019

Produktionsstart Ende 2021

► Grundstück(e) Hauptflurstück rund 67 000 m²

Gesamtfläche rund 95 000 m²

► Gebäude Fertigungs-, Versorgungs- und

Bürogebäude mit insgesamt rund 72 000 m² davon rund 10 000 m² Fertigungsfläche

► Mitarbeiter am Standort bis zu 700 (geplant)

► Fertigungsprozess Vollautomatisiert auf Basis 300mm Siliziumsubstrate

(Wafer) mit kleinsten Strukturbreiten perspektivisch

bis 65 nm

Informationen zur Halbleiter-Fertigung bei Bosch

Aktuelles Portfolio Beschleunigungs-, Drehraten-,

Massenfluss-, Druck- und Umweltsensoren sowie

Mikrofone, Leistungshalbleiter und

anwendungsspezifische Schaltungen (ASICs) für

Fahrzeugsteuergeräte

FertigungsstandorteReutlingen, Baden-Württemberg

(150mm- und 200mm-Technologie)

► Produktion Aus Reutlingen fertigt Bosch täglich rund 4,5 Millionen

MEMS-Komponenten und rund 1,5 Millionen ASICs

► Vertrieb Bosch Sensoren im Gegensatz zu den Halbleitern

werden nicht nur für den Eigenbedarf gefertigt,

sondern zum größten Teil vermarket

► Patente Bosch hält mehr als 1 000 Patente

und Patentanmeldungen im Bereich der MEMS-

Technologie

Auszeichnung
Deutscher Zukunftspreis 2008 für

den Durchbruch in der "Oberflächen-Mikromechanik"

► Historie Seit mehr als 45 Jahren entwickelt

mikroelektronische Bauteile und Systeme; vor 20 Jahren hat Bosch den Halbleiter-Fertigungsprozess für mikroelektromechanische Systeme (MEMS)

entwickelt und ist heute einer der führenden Hersteller